

TECHNICAL INFORMATION FOR J-04/590A

J-04/590A 说明书

特征

电气特性优良
耐热性能
机械强度
高模量

Features

Good electrical properties
Good heat resistance
Good adhesion strength
High thixotropic

用途

传用于温度传感器的包封

Application

Dipping material for electrical chips

1. 硬化前的状态和使用条件

Properties before curing

项目 Item	单位 Unit	J-04	590A
外观 Appearance	--	白或黑色液体 White thixotropic liquid	黑色液体 Black liquid
比重 Specific gravity (25℃)	--	1.16	1.13
粘度 Viscosity (25℃)	mPa.s	3600	2600
配合比 Mixing ratio (A/B)	Wt%	100	20
可使用时间 Pot life (100g,25℃)	hours	5	
凝胶时间 Gel time (150℃)	seconds	300	
硬化时间 Curing schedule	--	80℃×2hours+120℃×4hours or 100℃×5 hours	

2. 硬化物特性

Properties after curing

项目 Item	单位 Unit	J-04/590A
外观 Appearance	--	黑色 Black
热变形温度 Heat distortion temperature	℃	115
玻化温度 Glass distortion temperature	℃	120
热膨胀系数 Coefficient of thermal expansion	<Tg 1/℃ >Tg 1/℃	6.5×10^{-5} 1.7×10^{-4}
硬度 Hardness	室温 at room temperature shores	95
体积电阻 Volume resistance	25℃ Ω .cm	5×10^{15}
煮沸吸水率 Boiling water absorption	100℃1 小时 100℃ × 1hour %	0.1
吸水率 Water absorption	25℃1 天 (25℃ × 1day) 25℃7 天 (25℃ × 7days) %	0.05 0.45
诱电率 Dielectric constant	25℃、1Mhz --	4.1
诱电正接 Dielectric loss tangent	25℃、1Mhz --	0.005
引张强度 Tensile strength	25℃ MPa	80
弯曲强度 Bend strength	25℃ MPa	100
击穿电压 Dielectric breakdown voltage	25℃ Kv/mm	25
导热系数 Heat conductivity	25℃ W/m.K	0.30